

「2009年度版日本実装技術 ロードマップ／プリント配線板編」 詳細解説セミナー

■主 催：実装技術ロードマップG WG5

■担当部署：知的基盤部

■参加者数：50名

概 要

当協会の「電子実装技術委員会」に設置された「Jisso戦略専門委員会」の実装技術ロードマップG（委員長：高橋邦明氏）では、今般「2009年度版日本実装技術ロードマップ」本編、及び「プリント配線板編」を2009年6月に発刊致しました。

この報告書発行に当たり、「日本実装技術ロードマップ／プリント配線板編」のより詳細な内容をご理解頂き、今後の研究開発活動や事業化の促進のために、表記セミナーを開催致しました。

セミナーでは、2009年度版プリント配線板ロード

マップの各製品や技術についての動向の詳細を解説するとともに、次世代プリント配線板技術及びアメリカや国内電子機器メーカーのロードマップとの比較により、我が国プリント配線板の強みや弱みの解析も行いました。

加えて、2009年度版ロードマップでは紹介できなかった最新の技術動向やトピックスについての解説も行いました。

経済環境が厳しい中、50名の方に参加頂き、盛況の内に無事終了することが出来ました。



プログラム

○「プリント配線板関連技術の最新動向」

講師：実装技術ロードマップグループ 副委員長 宇都宮久修 氏

○「半導体パッケージからプリント配線板への要求」

講師：実装技術ロードマップグループ 副委員長 春田 亮 氏

○「リジッドプリント配線板ロードマップの解説」

講師：プリント配線板ワーキンググループ 委員 上原利久 氏（トッパンNECサーキットソリューションズ）

○「COF/TABロードマップの解説」

講師：プリント配線板ロードマップワーキンググループ 委員 山縣 誠 氏（三井金属鉱業）

○「フレキシブルプリント配線板ロードマップの解説」

講師：プリント配線板ロードマップワーキンググループ 委員 赤間史朗 氏（日本メクトロン）

○「サブストレートロードマップの紹介」

講師：プリント配線板ロードマップワーキンググループ 副主査 富田清志 氏（京セラSLCテクノロジー）

○「プリント配線板技術ロードマップの共通事項の解説」

講師：プリント配線板ロードマップワーキンググループ 委員 雀部俊樹 氏（メイコー）

○「微細化技術へのチャレンジ」

講師：プリント配線板ロードマップワーキンググループ 副主査 角井和久 氏（富士通）

○「部品内蔵基板へのチャレンジ」

講師：プリント配線板ロードマップワーキンググループ 委員 佐々田洋一 氏（新光電気工業）

○「ギャップアナリシスとまとめ」

講師：実装技術ロードマップグループ 副委員長 宇都宮久修 氏